



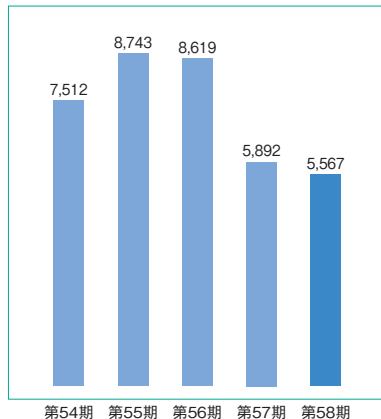
第 58 期 事業レポート

2025年4月1日～2026年3月31日

決算ハイライト(連結)

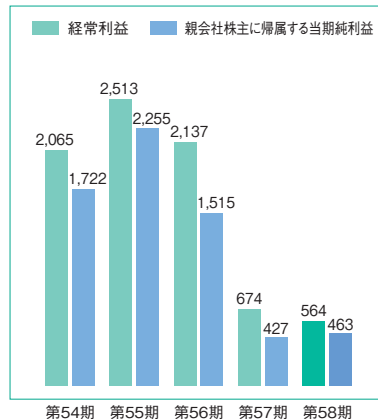
売上高

(単位：百万円)



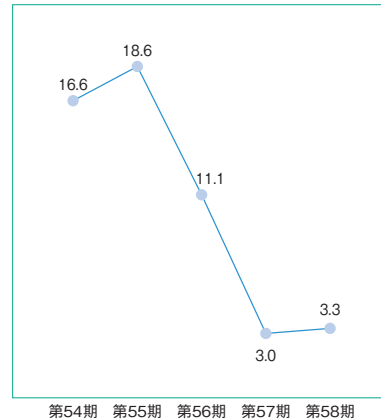
経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益

(単位：百万円)



自己資本利益率 (ROE)

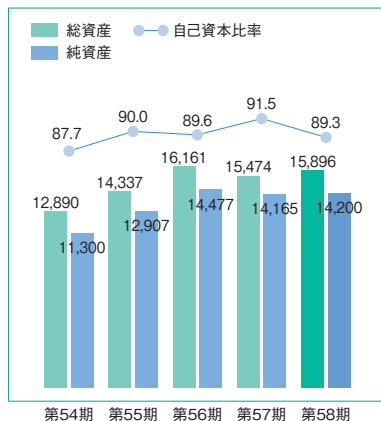
(単位：%)



総資産・純資産 自己資本比率

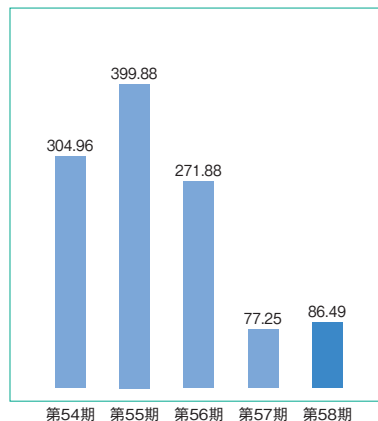
(単位：百万円)

(単位：%)



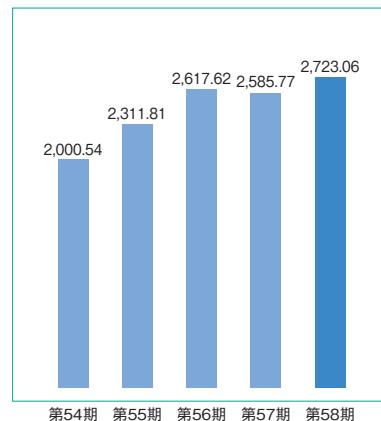
1株当たり当期純利益

(単位：円)



1株当たり純資産額

(単位：円)



トップメッセージ

平素は当社の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに第58期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）の事業の概況についてご報告申し上げます。

当連結会計年度における世界経済は、地政学的緊張や米中貿易摩擦の長期化により不透明な状況が続きました。米国では高関税による物価上昇懸念と雇用軟化を背景に利下げが実施され、欧州では外需不安や政治リスクが景気の下押し要因となりました。中国では不動産低迷や過剰生産、出生率低下等の構造的課題が重荷となり、日本では企業収益や株価が堅調な一方、円安・物価高によるコスト増もあり、景気回復は緩やかにとどまりました。

半導体業界におきましては、生成AI向けのGPU、ASIC、HBM（High Bandwidth Memory）への需要が好調に推移しましたが、非AI分野では在庫調整の影響を受け、需要は伸び悩みました。当社のテスト分野が対象とするパワー半導体市場では、EV需要の減速に加え、海外メーカーとの競争激化を背景に、半導体関連企業による投資抑制や業界再編の動きが相次ぎました。

このような環境において、当社は顧客ニーズに応える製品の開発に注力するとともに、パワーデバイス用テストやMAPハンドラ、新たにリリースしたリードフレームストリップハンドラなどを軸として、実機デモの実施や国内外の展示会への参加、トップセールスを通じた積極的な販売活動を展開しました。また、中期計画に基づく人的資本関連の成長投資として、株式給付信託（J-ESOP）の導入や従業員持株会における奨励金付与率の引き上げを行い、従業員の企業価値向上への意識醸成とエンゲージメント向上に努めました。

以上の結果、受注高は54億62百万円（前期比35.1%増）、売上高は55億67百万円（同5.5%減）、受注残高は25億56百万円（同4.0%減）となりました。製品別売上高はハンドラ25億47百万円（同53.9%増）、テスト19億74百万円（同34.8%減）、パーツ等10億46百万円（同13.5%減）となりました。

損益面は、減収に伴う売上総利益の減少等により、営業利益は3億1百万円（同30.7%減）、経常利益は5億64百万円（同16.3%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は4億63百万円（同8.3%増）となりました。



代表取締役社長 田中 賢治

生成AIの普及に伴うデータセンター投資の拡大、自動運転技術（ADAS）の高度化やEV（電気自動車）シフトを支える次世代パワー半導体の需要増加などを背景に、半導体製造装置市場は、短期的には変動しつつも中長期的には堅調な成長が予想されます。

このような状況を踏まえ、当社はシクリカルな市場環境下にあっても持続的な成長を目指すべく、2025～2027年度を対象期間とする中期計画「Enjoy2.1」を策定の上、各種施策に取り組んでおります。

中期計画では、測定における提案力と付加価値の創造を通じた事業成長に向け、基盤戦略および事業戦略を着実に遂行するとともに、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を一体的に推進する方針です。

足下では、生成AI関連需要を背景としたハンドラ分野の回復が見込まれる一方、EV市場低迷の長期化により、テスト分野の回復時期は従来想定より後ろ倒しとなる見通しですが、市場回復局面における需要を確実に取り込むため、100億円超の供給力確保と開発投資を継続してまいります。

また、2025年1月に子会社化した嶺光音電機株式会社とのテスト分野における共同開発を進めるなど、外部リソースも活用しながら中長期的な成長基盤の強化を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続きより一層のご支援とご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

AI需要を追い風にハンドラが急回復、5期連続の黒字を達成。 成長投資の加速とDOE導入により、中長期的な企業価値向上を推進。

パワー半導体市場の調整やEV市場の減速が続くなか、生成AIをはじめとする新たな需要の台頭により、半導体市場は大きな転換期を迎えています。このような事業環境下において、テセックはどのように舵取りを行い、いかなる成果を上げてきたのか。そして、新たに始動した中期経営計画「Enjoy2.1」の進捗や、今後の成長戦略・株主還元への取り組みについて、田中社長に伺いました。

Q 当期(2026年3月期)の事業環境および業績の概要をお聞かせください。

A 当期におけるパワー半導体市場は、前年に引き続きEV向けの調整局面が継続し、産業機器向けでも在庫調整が長引くなど、全体としては厳しい事業環境となりました。

当社事業においては、テストの受注・売上が低迷する一方、生成AIの普及を背景に、パワー制御分野のハンドラに対する需要が急激に立ち上がりました。

結果として、当期の連結業績は、売上高、営業利益、経常利益は前期比で減収減益となったものの、投資有価証券の売却益などの寄与もあり、当期純利益は増益を確保しました。

何よりも、厳しい環境下でありながら「5期連続の黒字」を達成できたことは、収益基盤の強化が進んできた証と考えています。上場後としては最長となる黒字継続期間も更新が続いており、これまでの取り組みの成果が表れた1年であったと認識しています。

Q AIにけん引される半導体市場の状況について、事業への影響をお聞かせください。

A AI向け半導体というと、GPUや最先端のメモリを真っ先にイメージされるかと思います。これらは確かに活況を呈していますが、大量のデータを処理するサーバーやデータセンターそのものが、実は膨大な電力を消

費しているという新たな課題を抱えています。そこで、電力を効率よく制御するパワー半導体の需要が、AIインフラの拡大に伴って高まってきました。これが、下期からの当社のハンドラ受注の強力な追い風となりました。

一方で、現在の顧客から提示される納期は非常にタイトであり、スピード感が強く求められています。そこで当社では、戦略モデルを中心に、製品の最終アセンブリの手前まであらかじめ部材を組み上げておく「計画生産」へのシフトを進めています。これにより、受注から出荷までのリードタイムを短縮し、お客様の旺盛な需要をタイムリーに捉える体制を構築しています。

Q 貴社におけるAIの活用状況や、今後の展開についてお聞かせください。

A AIの利活用については、当社においても重要な経営課題と捉え、全社的な推進を図っています。まずは身近な業務から始め、企画書や報告書などの文書作成の補助、あるいはソフトウェア開発におけるプログラミングの効率化といったドキュメンテーションや開発サポートの領域において、すでに実務負荷の軽減効果が現れ始めています。

今後は、製造業としてのコア領域への適用も進め、更なる業務効率化につなげていく方針です。

Q 当期は中期経営計画「Enjoy2.1」の初年度でした。手応えはいかがでしょう。

A 当期からスタートした3ヵ年の中期経営計画「Enjoy2.1」は、市場環境の急激な変化に柔軟に対応するため、毎期見直しを行う「ローリングプラン」を採用しています。初年度となる当期は、先述の通りAI需要によるハンドラの上振れとEV調整によるテストの低迷があったため、プランの軌道修正を行いました。

この計画で掲げている最大のテーマは、次の本格的な市場成長局面を見据えた「100億円超の供給力の確保」と「製品開発力の強化」です。その一環として、前期に子会社化した嶺光音電機株式会社とのシナジー創出が着実に進んでおり、同社が強みとする「動特性試験技術」と、当社の持つテスト・ハンドラ技術の統合に確かな手ごたえを感じています。

また、成長投資の核となる研究開発投資については、過去最大規模となる6.2億円の投資を計画しています。中長期的な競争力の源泉である技術開発へは、今後も積極的に経営資源を投入していく方針です。

Q 株主還元策、特に配当方針の変更や自社株買いについてお聞かせください。

A 当社は、中長期的な企業価値向上を果たす上で、株主の皆様への安定的かつ魅力的な利益還元を重要課題のひとつと位置付けています。当期においては、総額約6億円規模の機動的な自社株買いを実施し、資本効率の向上と株価への配慮を行いました。

配当方針については、中期経営計画の期間中、業績の周期的な変動に左右されず、予見性の高い配当を実施す

るため、株主資本配当率（DOE）4%を目安とした安定配当を継続しています。

さらに、次期（2027年3月期）より、従来の期末一括配当を見直し、新たに中間配当を導入することで、年2回の配当を実施することになりました。配当の機会を分けることで、株価の平準化を図るとともに、株主の皆様にご当社の株式をより長期的かつ安心して保有していただきたいと考えています。

Q 最後に、株主の皆様へメッセージをお願いします。

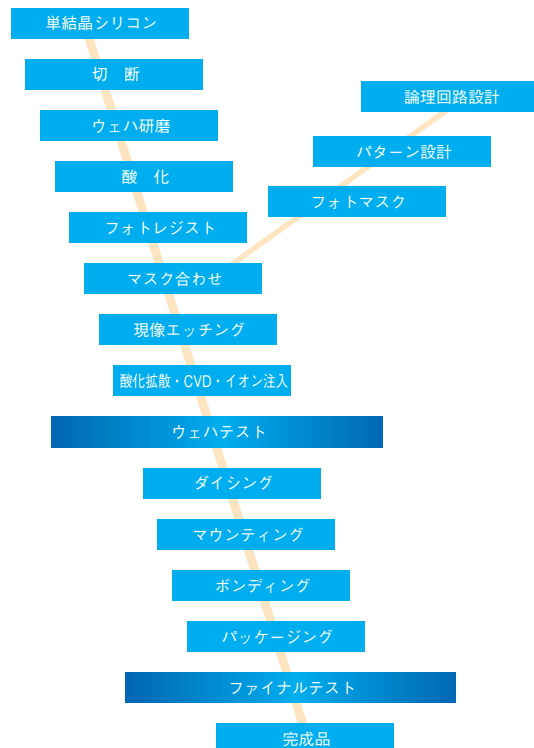
A 半導体業界は市場サイクルの波が激しい世界ですが、当社の主戦場であるパワー半導体市場は、脱炭素社会の実現やAIインフラの拡大を背景に、中長期的には間違いなく持続的な成長が見込まれます。次期の通期連結業績は、ハンドラの好調維持などを軸に、売上高63億円、営業利益4億50百万円と、増収増益への転換を予想しています。

現在、当社のPBR（株価純資産倍率）が依然として低い水準にあることについては、経営陣一同真摯に受け止めており、資本コスト（7～9%）を意識した資本配分を進め、中長期的な企業価値向上に取り組んでまいります。

今後も、優れた半導体検査装置を世界中に供給することで、快適で安全な社会に貢献するというミッションのもと、持続的な成長と株主還元の充実に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続き当社方針へのご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

半導体検査装置の、
リーディングカンパニーとして、グローバルに、
そして独創的にカスタマーニーズにお応えしています。



製造された各種半導体の品質による分類・選別処理を自動的に行うハンドラ、ハンドラと連動して半導体の電気特性を高速・高精度で測定し、分類・選別の基準となるデータを提供するテスト。これら半導体検査装置は半導体の最終検査（ファイナルテスト）を担い、その精度は半導体、さらには電子機器などの最終製品の品質を決定するといっても過言ではありません。

また、近年は社の強みである高電圧・大電流なパワー半導体（※）測定技術を継承しつつ、長年蓄積してきた測定技術を活用し、ウェハテスト工程に対応した新しいタイプのテストにも注力しております。複数チップを同時測定処理することにより、従来テストに比べ大幅に生産性向上を図ることができます。

テセックは、ハンドラとテストの専門メーカーとして、また、それらを組合わせたテストシステムのトータルサプライヤーとして、長年のノウハウと確かな技術力を駆使して、高品質・高信頼を追求してきました。

さらに今、トータルシステムや特化したカスタマーニーズへの対応など、検査装置の領域を超えたソリューションの提供にも積極的に挑戦しています。

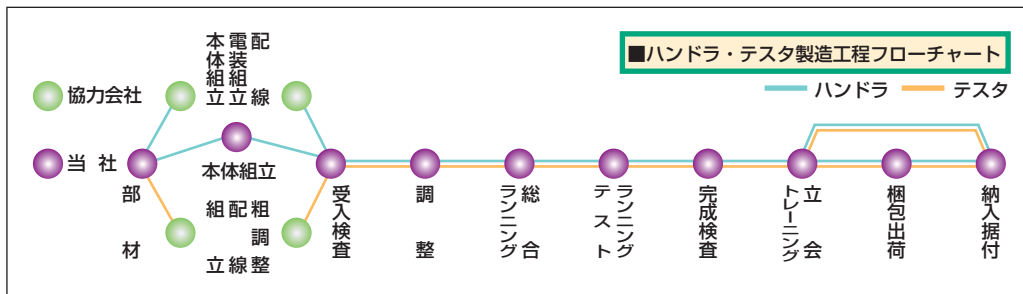
パワー半導体とは = 電力制御や供給機能がある半導体

例えば自動車では、
従来の内燃機関はガソリンなど燃料を使用 ⇒ 排気ガスを排出
パワー半導体は燃料を使わず、電気を使用
電気（電圧や電流）により動力を発生し制御 ⇒ 排気ガスゼロ



パワー半導体による地球温暖化抑制とCO₂削減が可能

この**パワー半導体**の信頼性試験に**当社製品**が貢献！



半導体業界は刻々と変わりゆく技術やデバイスの多様化によって、当社が手がける検査装置に求められるレベルも高度になりつつあります。このような時代の流れに対応するために、これまで独自技術のオリジナリティを磨き、他社との差別化を図ってきました。すでに定評のあるハンドラとテストはもちろん、MEMSハンドラや一貫システムまで、最先端の市場を見据えた幅広いラインナップでカスタマーニーズにお応えしています。

ハンドラ

ハンドラとは、接続されたテストからの測定データを受け、設定されたレベルに応じて各種半導体デバイスを自動的に分類・選別する装置です。

チェンギットによりデバイスの形状、サイズ、重さなどの変化にも柔軟に対応でき、同時にコンパクト設計、シンプル機構、優れた操作性、低価格を実現しています。

対象半導体の種類、用途によっては温度試験対応などの機能が付加され、さらに半導体製造の後工程となるリード切断やマーキングを同時に行う一貫システムも充実しています。

テスト

テストとは、各種半導体デバイスの電気特性を高速・高精度に測定するテストシステムです。パソコンの搭載で、ウィンドウズの画面上で対話型式によるテストプログラムを簡単に作成でき、ネットワークにも接続できます。

特に大電流、高電圧に対応するテストシステムでは高度な計測技術により他社の追随を許さない性能を誇り、長年にわたって高シェアを維持しています。また、ロジックICを対象としたDC測定、時間測定、ファンクション測定などの分野もカバーしています。

ストリップフレーム上のデバイスを個片化することなく測定する装置<5880-IH>を新たにリリースいたしました。

従来モデルで培われたアライメントや位置・高さ補正機能をさらに強化し、高耐荷重・高精度ステージと組み合わせることで、多数個同時測定を最適なコンタクトストロークで実現します。温度環境試験に対応することで信頼性の高い検査とともに、新たな付加価値を提供します。検査工程における生産能力が大幅に向上し、生産効率の飛躍的な改善に貢献します。



MEMSテストハンドラ



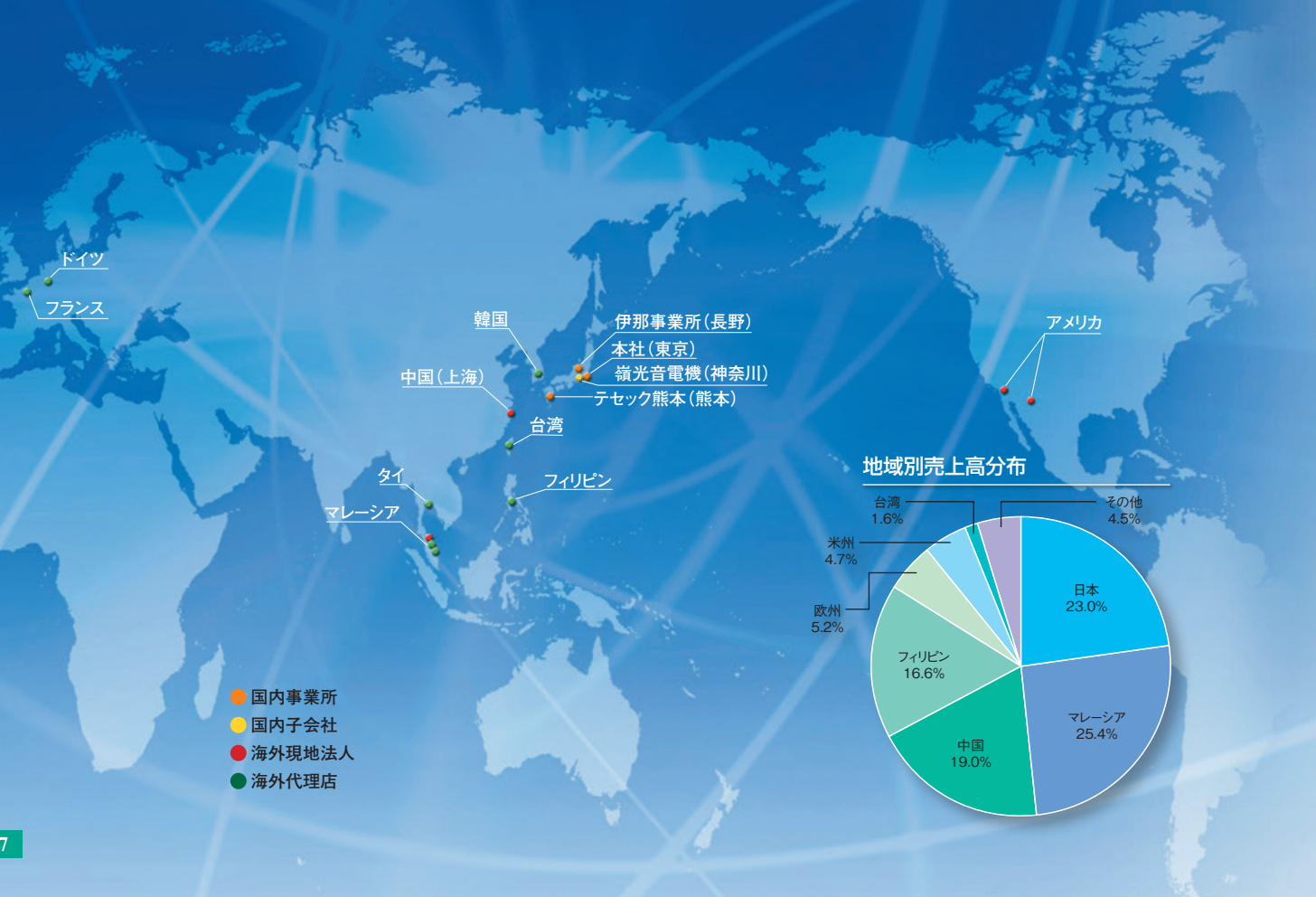
パワーデバイス用パラレルテストシステム



5880-IH

半導体製造工場が稼働する世界全地域をカバー。 このネットワークが、信頼をより強固に。

リアルタイムの情報を世界各地から収集・分析し、製品や提案として発信するテセックのビジネスモデル。設立当時に、半導体先進国だったアメリカ系企業から技術力を認められ、いち早くグローバルに展開できたことが、独自性を際立たせるきっかけとなりました。以来今日まで拓かれた販売・サービス網は、半導体製造工場のある世界全域をカバーし、なかでもアメリカ、マレーシア、中国の現地法人では、現地のお客様に向けてきわめて密接な営業活動・情報収集を実践しています。そこから生まれる新たな製品・ソリューションは、海外代理店も巻き込んでまさにグローバルに波及し、世界各地での半導体ビジネスに貢献しています。



連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	前連結会計年度 2025年3月31日現在	当連結会計年度 2026年3月31日現在
(資産の部)		
流動資産	9,300	9,076
現金及び預金	4,352	3,499
電子記録債権	69	59
売掛金	1,782	1,386
有価証券	198	1,734
金銭の信託	-	1
製品	131	134
仕掛品	1,840	1,494
原材料	786	562
未収還付法人税等	34	17
未収消費税等	-	104
その他	108	103
貸倒引当金	△ 4	△ 22
固定資産	6,174	6,820
有形固定資産	1,840	1,834
建物及び構築物	2,554	2,491
減価償却累計額	△ 2,244	△ 2,187
建物及び構築物(純額)	310	304
機械装置及び運搬具	123	139
減価償却累計額	△ 114	△ 121
機械装置及び運搬具(純額)	8	17
工具、器具及び備品	706	766
減価償却累計額	△ 629	△ 687
工具、器具及び備品(純額)	76	78
土地	1,440	1,434
建設仮勘定	4	-
無形固定資産	539	532
ソフトウェア	11	13
ソフトウェア仮勘定	340	380
技術関連資産	184	135
その他	2	2
投資その他の資産	3,794	4,453
投資有価証券	3,399	4,022
破産更生債権等	-	36
退職給付に係る資産	164	235
繰延税金資産	1	0
保険積立金	208	184
その他	20	9
貸倒引当金	-	△ 36
資産合計	15,474	15,896

科 目	前連結会計年度 2025年3月31日現在	当連結会計年度 2026年3月31日現在
(負債の部)		
流動負債	834	1,032
買掛金	74	216
未払金	86	100
短期借入金	40	-
1年内返済予定の長期借入金	47	44
未払費用	115	115
契約負債	161	151
未払法人税等	41	160
賞与引当金	143	139
製品保証引当金	47	29
修繕引当金	29	28
その他	47	46
固定負債	475	663
長期借入金	276	216
退職給付に係る負債	56	59
株式給付引当金	-	37
資産除去債務	10	10
繰延税金負債	129	337
その他	2	1
負債合計	1,309	1,696
(純資産の部)		
株主資本	13,262	12,757
資本金	2,521	2,521
資本剰余金	3,382	3,370
利益剰余金	7,979	7,676
自己株式	△ 620	△ 811
その他の包括利益累計額	900	1,440
その他有価証券評価差額金	765	1,208
為替換算調整勘定	135	232
非支配株主持分	1	1
純資産合計	14,165	14,200
負債純資産合計	15,474	15,896

連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前連結会計年度		当連結会計年度	
	自：2024年4月1日 至：2025年3月31日		自：2025年4月1日 至：2026年3月31日	
売 上 高	5,892		5,567	
売 上 原 価	3,634		3,400	
売 上 総 利 益	2,257		2,167	
販売費及び一般管理費合計	1,822		1,866	
営 業 利 益	434		301	
営 業 外 収 益 合 計	257		302	
営 業 外 費 用 合 計	16		38	
経 常 利 益	674		564	
特 別 利 益 合 計	－		176	
税金等調整前当期純利益	674		741	
法人税、住民税及び事業税	261		267	
法 人 税 等 調 整 額	△ 13		10	
法 人 税 等 合 計	247		278	
当 期 純 利 益	427		463	
非支配株主に帰属する当期純利益	△ 0		0	
親会社株主に帰属する当期純利益	427		463	

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	前連結会計年度		当連結会計年度	
	自：2024年4月1日 至：2025年3月31日		自：2025年4月1日 至：2026年3月31日	
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,767		1,464	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 900		△ 1,402	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 495		△ 1,094	
現金及び現金同等物に係る換算差額	89		135	
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	461		△ 897	
現金及び現金同等物の期首残高	3,602		4,063	
現金及び現金同等物の期末残高	4,063		3,166	

連結対象子会社

日本	嶺光音電機株式会社（横浜市）
アメリカ	TESEC, INC. /Head Office（カリフォルニア州） /Arizona Office（アリゾナ州）
マレーシア	TESEC（M）SDN.BHD.
中国	泰賽国際貿易（上海）有限公司

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

(単位：百万円)

	株主資本					その他の包括利益累計額			非支配株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	その他の 包括利益 累計額合計		
当 期 首 残 高	2,521	3,382	7,979	△ 620	13,262	765	135	900	1	14,165
当 期 変 動 額										
剰 余 金 の 配 当			△ 383		△ 383					△ 383
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益			463		463					463
自 己 株 式 の 取 得				△ 599	△ 599					△ 599
自 己 株 式 の 処 分		△ 3		18	14					14
自 己 株 式 の 消 却		△ 8	△ 382	391	－					－
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）						443	96	540	0	540
当 期 変 動 額 合 計	－	△ 12	△ 303	△ 190	△ 505	443	96	540	0	35
当 期 末 残 高	2,521	3,370	7,676	△ 811	12,757	1,208	232	1,440	1	14,200

会社概要

社名	株式会社テセック TESEC Corporation
所在地	本社（〒207-0023） 東京都東大和市上北台三丁目391番地の1 TEL：042-566-1111（代） FAX：042-562-6161 伊那事業所（〒399-4601） 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪16346 TEL：0265-79-6611（代） FAX：0265-79-7883 テセック熊本（〒861-2202） 熊本県上益城郡益城町田原1155-12 テクノ・リサーチパーク テクノ・ラボラトリビル2F TEL：096-287-1551 FAX：096-287-1552
設立	1969年12月22日
資本金	25億21百万円
従業員数	211名（連結）、172名（単体）（2026年3月31日現在）
国内子会社	嶺光音電機株式会社
海外現地法人	TESEC, INC.（アメリカ） TESEC（M）SDN. BHD.（マレーシア） 泰賽國際貿易（上海）有限公司（中国）
事業内容	半導体検査装置であるハンドラ（半導体の電氣的測定結果をもとに性能毎に分類・選別する装置）、 テスト（半導体の性能を電氣的に測定する装置） およびパーツ等（予備部品、保守部品等）の開発・ 製造・販売
URL	https://www.tesec.co.jp

役員（2026年6月26日現在）

代表取締役社長	田中賢治
取締役	宮脇浩幸
取締役	渡邊弘一
取締役	戸田雄介
取締役（常勤監査等委員）	尾亦利夫
取締役（監査等委員）	南忠良
取締役（監査等委員）	舩川博昭
取締役（監査等委員）	上石奈緒

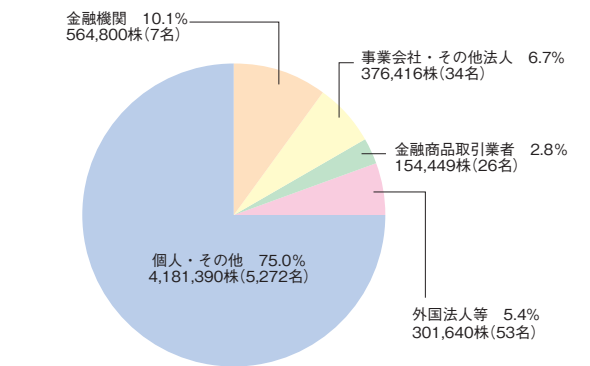
株式状況（2026年3月31日現在）

発行可能株式総数	20,000,000株
発行済株式の総数	5,578,695株
株主数	5,392名
大株主（上位10名）	

株主名	持株数	持株比率
田中 綏子	376千株	7.0%
日本生命保険相互会社	186	3.5
MM Investments株式会社	181	3.4
勝田 知男	177	3.3
山村 博	166	3.1
株式会社りそな銀行	164	3.1
株式会社日本カストディ銀行	150	2.8
テセック社員持株会	122	2.3
大塚 佳苗	106	2.0
大塚 正樹	100	1.9

（注）1.持株比率については、自己株式数（214,442株）を控除して算出しております。
2.株式会社日本カストディ銀行（150千株）は、株式給付信託（J-ESOP）導入に伴い設定された信託であります。なお、当該株式は上記自己株式数には含まれておりません。

所有者別株主数分布



株 主 メ モ

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 6月
基準日 3月31日
株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
電話 0120-232-711（通話料無料）
郵送先 〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
同取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
公告方法 電子公告により行います。
ただし、事故その他やむを得ない事由
によって電子公告をすることができな
い場合は、日本経済新聞に掲載いたし
ます。
URL <https://www.tesec.co.jp>
1単元の株式数 100株

株式会社 テセック

本社 〒207-0023 東京都東和上市北台三丁目391番地の1
TEL 042-566-1111（代） FAX 042-562-6161
伊那事業所 〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪16346
TEL 0265-79-6611（代） FAX 0265-79-7883
テセック熊本 〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原1155-12
テクノ・リサーチパーク テクノ・ラボラトリビル2F
TEL 096-287-1551 FAX 096-287-1552

URL <https://www.tesec.co.jp>